



**新聞聯絡人：**

**Soitec Contact:**

Camille Darnaud-Dufour  
Vice President, Communications  
Mobile (France): +33-6-79-49-51-43  
e-mail: camille.darnaud-  
dufour@soitec.com

廿一世紀公關顧問  
唐毅倫、劉怡  
電話：(02) 2577-2100 分機 802、803  
傳真：(02) 2577-1600  
E-mail：ellen.tang@erapr.com  
kay.liu@erapr.com

## **Soitec 宣佈全球策略性拓展計畫以因應絕緣層上覆矽與其他工程基板日益增加的需求**

*將擴充在法國的研發部門與產能，並著眼全球工業布局在新加坡設立新廠區*

台北訊—7 月 1X 日—絕緣層上覆矽 (SOI) 晶圓與其它半導體生產用工程基板的領導製造商 Soitec (Euronext Paris)，今天宣布其最新擴充發展策略，目的在於因應全球對絕緣層上覆矽 (SOI) 與其他工程基板不斷增加的需求。為達到此一目標，Soitec 將增加目前在法國廠區的產能，同時在新加坡設立新的生產據點，進一步擴大其全球據點。上述策略性投資獲得來自業務及獲利方面的正面回應，將延伸 Soitec 在全球市場上的行銷與技術領導地位。

Soitec 總裁兼執行長 André-Jacques Auberton-Hervé 指出：『我們的策略性投資計畫概念為率先發展半導體產業所需的工程基板技術，進而投資產能以達成客戶的技術需求。我們長久以來與 CEA Léti 實驗室保持密切的合作聯盟，再加上我們的地點位於一向堅定支持公開與私人合作計畫的 Grenoble 區，使我們能夠在業界保持領導的地位。目前進行中的投資計畫，使我們能夠因應量產市場的需求，並協助電子系統的革新。同時，為了符合全球晶片製造商，包括亞洲晶圓代工廠商所預期的需求量增加，我們將在新加坡增設新的生產基地，進一步支援全球產能。這樣一來，無論何時何地，只要客戶需要這些技術，Soitec 皆能大量提供。』

### **擴充在法國的生產與研發據點**

截至 2006 年 3 月為止，Soitec 在 Bernin 生產據點的投資已超過 3.5 億歐元，預計在設備裝設完成時的總投資將超過 5 億歐元，員工人數接近 1,000 位。Soitec 集團並證實將於今年上半年在 Bernin II 增設兩條 300 毫米的生產線。為進一步提升產

-接下頁-

能與研發能力，並支援位於 Grenoble 的 TraciT Technologies（於最近收購），Soitec 花費將近 1,300 萬歐元，從 MEMSCAP（Euronext: MEMS）手中購買毗鄰於 Soitec Bernin 廠區、佔地 1,300 平方公尺且設備完善的無塵室。在上述種種投資的挹注之下，Soitec 針對 300 毫米晶圓的年產能預估（中期範圍），將可從目前的 72 萬片提升至 100 萬片。

關於 Bernin 的策略性研發投資計畫，Soitec 將繼續為全球半導體產業供應創新工程基板。而由 Soitec 與 CEA Léti 合作的計畫—NanoSmart，則是集團最新、可能也是目前最被看好的案子。目前該案已被法國政府列為全國、甚至是全歐及全球半導體產業的關鍵計畫，合作案總預算為五年 1.7 億歐元，其中在歐盟同意此合作案後，Soitec 將接受來自於政府的資助與借貸，金額約達 6,000 萬歐元，而 CEA Léti 則會收到約 2,000 萬歐元的資助。該計劃會在未來五年內再雇用至少 100 名研究人員，投入 Soitec Smart Cut™ 技術的新應用開發。此外，該計畫可在 Soitec 的授權策略基礎上加強其技術提升，並支援高階基板新標準的建立。Soitec 日前才接獲來自當地政府官員的確認，表明願意支援其他發展計畫。

### **在新加坡設立生產據點**

為了搭配目前在 Bernin 進行的擴充計畫，Soitec 進一步選擇在新加坡設立新的 300 毫米 SOI 晶圓廠，名為三號晶圓廠。這座預定在 8 月底動土的晶圓廠，佔地 2.7 公頃，並備有超過 4,000 平方公尺的無塵室，另有多餘土地可供未來需要時開發擴充，預估運作至最高產能的總投資將達 3.5 億歐元。該生產線將於 2008 年中期開始啟動，預期一年最多將能生產 100 萬片晶圓，在兩年後便可與市場成長中的需求同步，到 2009 年時，此廠區預估會雇用約 500 名人員。

新加坡經濟發展局主席張銘堅先生非常歡迎 Soitec 加入新加坡的電子產業，他表示：『我們十分榮幸 Soitec 這家全球 SOI 晶圓的領導製造商在眾多國家中，選擇了新加坡設立第一座在法國以外的生產據點。這座晶圓廠使用最先進的技術，充分反映出新加坡對於複雜技術的敏感度及反應能力，並為新加坡的半導體產業注入了新的動力。我們非常期待與 Soitec 建立穩定而長久的合作關係。』

Auberton-Hervé 補充說明：『Soitec 在新加坡 Pasir Ris 晶圓廠園區的新據點，擁有最頂尖的設備，象徵著公司的另一個里程碑。由於新加坡為一個以美金為主要交易貨幣的市場，在此設立晶圓廠將能夠提升我們的全球競爭力。新加坡擁有具優勢的環境，將加速我們發展策略的成功，並使我們與區域內主要客戶與合作夥伴建立更穩固的關係。因此，我們在全球的客戶將可更快、更容易地從 Soitec 獲得他們所需的 SOI 技術與製程專業知識。這對於 SOI 未來進入量產，並吸引更多晶片領導廠商，選擇 SOI 技術製造他們新一代裝置，以因應大量電子產品市場需求。』

Auberton-Hervé 最後表示：『Soitec 十分滿意目前全球擴充計畫的進度。該計畫不但為我們的投資者創造了最大價值，更進一步將其創新優勢上應用在授權策略上。我們十分感謝投資者近來在增資方面對公司的支持，給予我們足夠的財務資源以實現我們的目標。我們也感謝客戶對於 Soitec 的支持，讓我們在投入這項擴充計畫時更有信心與遠見。』他並補充說明一項最新的案例，一家公司剛與 Soitec 續約至 2007 年 12 月，合約總金額達 1.8 億美元。像這樣金額追加的合約，不但為 Soitec 的未來提供了更清晰的願景，更肯定了 Soitec 即便在 2006 到 2007 會計年度匯率的不利因素下，也能獲得 4 億歐元的預期獲利。此外，長期成長預估亦將隨之提升。

### 關於 Soitec Group

Soitec Group 是全球工程基板創新與製造的領導者，為現今最先進的電子產品與奈米技術提供發展基礎。公司總部位於法國 Bernin，生產眾多工程基板，其中包括 SOI 與應變絕緣矽，並運用 Soitec 專利 Smart Cut™ 技術 – 業界奉行的標準。Soitec 擁有遍佈全球的經營據點、專利技術、以及領先業界的產能，協助業者提升效能與省電效率，滿足全球消費者對於省電、行動電子產品的需求。該公司的股票與可轉換公司債都在法國股市掛牌交易。詳細資訊請參考該公司網站 [www.soitec.com](http://www.soitec.com)

###

*Soitec 的 Smart Cut 及 UNIBOND，是 S.O.I. TEC 絕緣層上覆矽技術的註冊商標。*